

深圳市鸿富诚新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券代码：301716 证券简称：鸿富诚 编号：2026-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
形式	☒ 现场 ☐ 网上 ☐ 电话会议
参与单位名称	易方达基金、大成基金、摩根士丹利基金、新华基金、平安基金、南方基金、宝盈基金、银华基金、鹏华基金、博时基金、水璞基金、华西基金、前海开源基金、信达澳亚基金、中信建投、国金证券、国盛证券、广发证券、国信证券、光大证券、中金公司、中泰证券、西部证券、招商证券、天风证券、长城证券、浙商证券、华创证券、恒泽投资、温氏投资、博普资产等（排名不分先后） （参会者已签署书面调研承诺函，在交流活动中，公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。下文会议纪要中的内容不代表公司对未来的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。）
时间	2026 年 10 月 13 日（星期二）
地点	深圳市宝安区福永街道凤凰社区福永东大道 7 号 C 栋二层会议室
上市公司接待人员	副总经理、董事会秘书：杨健虹先生 证券事务代表：余娜女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司情况介绍 公司成立于 2003 年 5 月 13 日，于 2021 年 12 月 2 日整体变更为股份有限公司，并于 2026 年 9 月 29 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，注

册地位于深圳市宝安区，是一家专注热管理、电磁屏蔽和吸波等先进电子功能材料及器件研发、产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业。目前，公司已在重庆、浙江、武汉以及马来西亚、泰国设有子公司，形成国内外协同的研发制造与服务网络，业务覆盖数据中心、智能汽车、5G 通信及消费电子等领域。

公司核心产品涵盖三大类：一是热管理材料及器件（碳基导热垫片、金属碳基复合材料等）；二是电磁屏蔽材料（包裹类导电泡棉、全方位导电泡棉等）；三是吸波材料（水溶性吸波材料等）。

公司是目前行业内极少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模化应用的企业，也是国内极少数已经成功实现 TIM1 热界面材料小批量供应的企业。2025 年度，公司实现营业收入 70,666.16 万元，同比增长 114.34%；净利润 27,031.82 万元，同比增长 278.04%。

二、互动交流环节

1、公司石墨烯垫片的性能是否领先？行业地位如何？

答：公司采用自主创新的取向技术，实现石墨烯材料的垂直排列，充分挖掘石墨烯在垂直方向的优异导热性能，导热系数最高可达 130W/m·K，热阻低于 0.06℃·cm²/W，且回弹性好，可有效解决 AI 高功率芯片大热流密度及翘曲形变导致的核心散热难题，成为行业内极少数能够量产制备石墨烯导热垫片并实现规模应用的企业。具体行业地位请参考公开行业报告。公司将进一步加强研发和产业化投入，提升综合竞争力。

2、公司热管理产品的技术迭代路径是怎样的？

答：公司热管理产品遵循清晰的技术迭代路径，逐步从传统高分子基复合材料，向高性能、高附加值的新型热界面材料及金属基复合材料升级，整体呈现“由低性能向高性能、由单一功能材料向多功能集成”的演进态势。迭代历程清晰可追溯：第一代产品为传统填充型导热垫片，核心聚焦通信、消费电子等散热场景；第二代升级为高填充与取向型材料，应用场景拓展至新能源汽车电控、5G 基站及工业电源等领域；当前已迭代至第三代产品，包括先进石墨烯导热垫片及金属碳基复合材料，可全面满足 AI 高功率芯片、数据中心、高功率 IGBT 等前沿领域的极致散热需求。

	3、公司石墨烯导热垫片与金属碳基复合垫片的应用场景有何区别？ 答：石墨烯导热垫片和金属碳基复合垫片定位不同，石墨烯导热垫片终端面向 AI 高功率芯片、数据中心、光模块、智能汽车等领域，当前主要应用于高功率 AI 芯片 TIM1.5/2 场景及智能驾驶 TIM1.5/2 场景；拓展进度主要取决于客户对高性能热管理材料的迫切性与成本之间的综合考量。而金属碳基复合材料采用多层复合技术，将低熔点金属与高导热材料结合，兼具低热阻、优异机械回弹性与界面稳定性，可重复使用，有效解决传统热界面材料“热阻低而难以重复使用、可重复使用却热阻高”的行业痛点，为高功率芯片测试提供良好解决方案，目前主要应用于高功率 AI 芯片板卡测试。 4、公司目前在手订单情况如何？ 答：根据公司招股说明书披露，公司目前在手订单较为充足，下游 AI 数据中心、智能汽车等领域总体上仍处于高速增长阶段，公司也在积极拓展新的应用场景、开拓新的优质客户。 5、公司客户认证与导入周期有多长？新客户拓展进展如何？ 答：高端热界面材料的客户导入通常需经历材料送样、性能测试、可靠性验证、小批量试产到批量供货等多个阶段，头部芯片与服务器客户的完整认证周期一般在一年至数年不等。在新客户拓展方面，公司正借助营销服务网络及总部基地建设项目完善境内外营销与技术服务体系。因涉及商业保密，公司不便披露具体客户名称及合作进度，敬请谅解。 6、公司海外客户对接进度如何？ 答：公司始终重视海外市场的拓展，与现有客户及相关潜在客户均保持着正常的技术交流与业务沟通，持续跟进海外市场的需求与机会。因涉及商业保密，公司不便披露具体客户名称及合作进度，敬请谅解。
附件清单	无
日期	2026 年 10 月 13 日